

**性能特点：**

- 频带：7GHz~13GHz
- 插入损耗：1.2dB@13GHz
- 隔离度：34dB@13GHz
- 开态输入回波损耗：18dB
- 开态输出回波损耗：18dB
- 关态输出回波损耗：19dB
- 芯片尺寸：1.7mm×1.3mm×0.1mm

**产品简介：**

HH-SW20713 是一款 GaAs 匹配式单刀双掷开关芯片，该芯片输入输出均加有隔直电容，在 7GHz~13GHz 频率范围内插损小于 1.2dB，隔离度大于 34dB。

**电参数：( TA=25°C )**

指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	7GHz-13GHz			GHz
插入损耗	-	1.2	-	dB
隔离度	-	34	-	dB
输入回波损耗 ( ON )	-	18	-	dB
输出回波损耗 ( ON )	-	18	-	dB
输出回波损耗 ( OFF )	-	19	-	dB

**使用限制参数：**

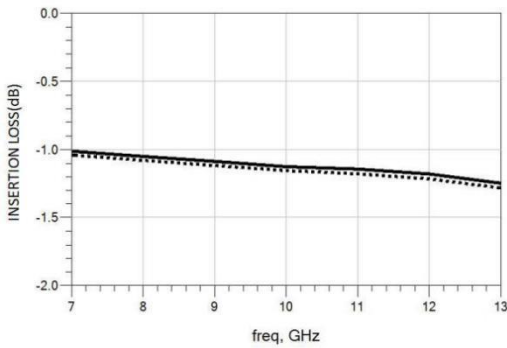
最大输入功率	27dBm
存储温度	-65°C-150°C
使用温度	-55°C-85°C

**真值表：**

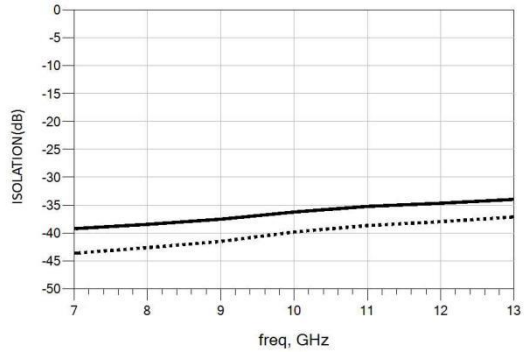
V1	REC to RF1	REC to RF2
0V	on	off
5V	off	on

典型曲线：

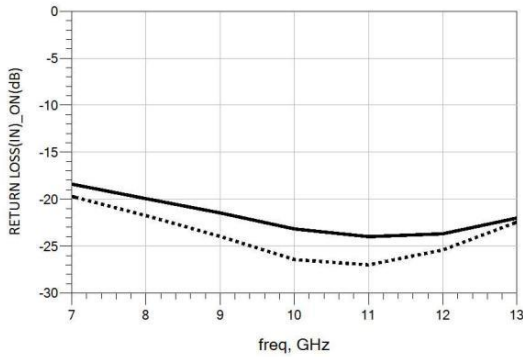
插入损耗



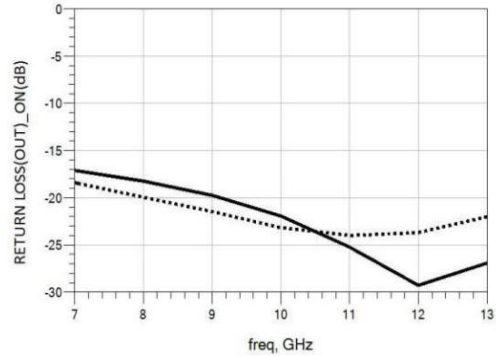
隔离度



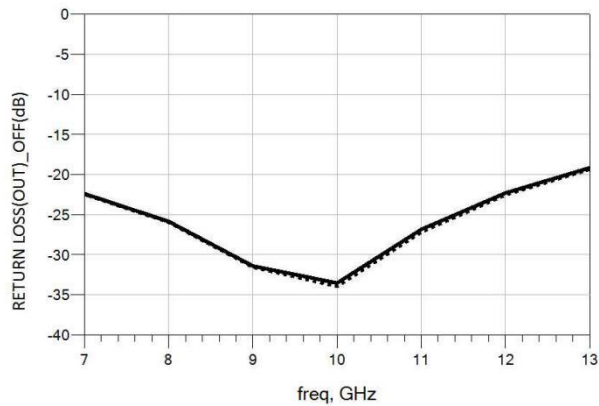
开态输入回波损耗



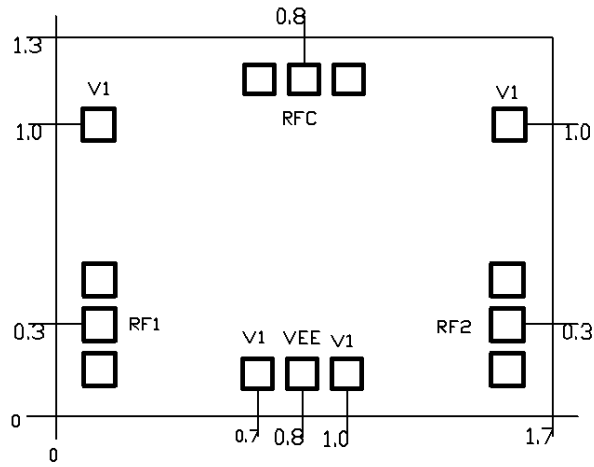
开态输出回波损耗



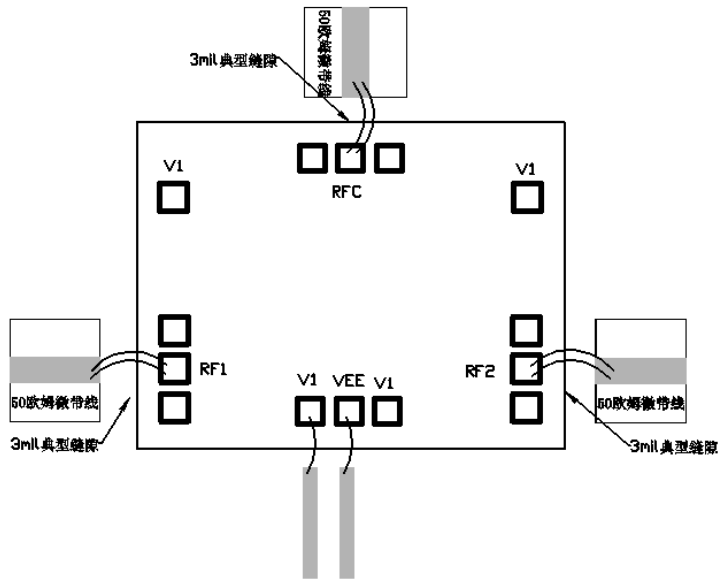
关态输出回波损耗



尺寸图：(单位 mm)



建议装配图：



**使用说明：**

**存储：**芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

**清洁处理：**裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

**静电防护：**请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

**常规操作：**拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

**装架操作：**芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

**键合操作：**输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度 300um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）